

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 5 月 28 日 (2009.5.28)

【公開番号】特開 2008-62260 (P2008-62260A)

【公開日】平成 20 年 3 月 21 日 (2008.3.21)

【年通号数】公開・登録公報 2008-011

【出願番号】特願 2006-241221 (P2006-241221)

【国際特許分類】

B 2 3 K 26/00 (2006.01)

B 2 3 K 26/08 (2006.01)

B 2 3 K 26/04 (2006.01)

H 0 1 S 3/04 (2006.01)

H 0 1 S 3/094 (2006.01)

【F I】

B 2 3 K 26/00 Z

B 2 3 K 26/08 B

B 2 3 K 26/04 C

H 0 1 S 3/04

H 0 1 S 3/094

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 4 月 10 日 (2009.4.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

対象物にレーザ光を照射することにより表面加工や切削加工を行うレーザ加工装置であって、

固体からなるレーザ媒質をレーザ励起光で励起させることにより、対象物に照射するためのレーザ光を発生させるレーザ発振部と、

照射するレーザ光の光軸に対して直交方向にレーザ光を走査させるために駆動される走査用モータと、

照射するレーザ光の光軸方向に焦点位置を移動させるために駆動される焦点位置制御用モータと、

上記走査用モータに駆動電流を供給する走査用増幅器が実装された走査回路基板と、

上記焦点位置制御用モータに駆動電流を供給する焦点位置制御用増幅器が実装された焦点位置制御回路基板と、

上記レーザ発振部、上記走査回路基板及び上記焦点位置制御回路基板が取り付けられた 1 枚の金属板と、

上記金属板に取り付けられた放熱部材とを備え、

上記レーザ発振部は、上記金属板の第 1 面に取り付けられ、

上記放熱部材は、上記金属板における上記第 1 面と反対側の第 2 面に対して、上記レーザ発振部に対向する位置に取り付けられていることを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項 2】

上記走査回路基板及び上記焦点位置制御回路基板の一方が上記第 1 面に取り付けられ、他方が上記第 2 面に取り付けられていることを特徴とする請求項 1 に記載のレーザ加工装置

。

【請求項 3】

上記レーザ発振部は、固体のレーザ媒質に対して両端部からレーザ励起光を入射させることによりレーザ光を発生させることを特徴とする請求項 1 に記載のレーザ加工装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 7】

本発明の一実施形態によるレーザ加工装置は、上記構成に加えて、上記レーザ発振部が、断続的にレーザ光を発生させるように構成される。